

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 11 日(11.12.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/196501 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) *C08K 5/544* (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) *H05K 3/46* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/064624
- (22) 国際出願日: 2014 年 6 月 2 日(02.06.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-116901 2013 年 6 月 3 日(03.06.2013) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 長谷部 恵一(HASEBE, Keiichi); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 鹿島 直樹(KASHIMA, Naoki); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 瀧口 武紀(TAKIGUCHI, Takenori); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 小柏 尊明(OGASHIWA, Takaaki); 〒9921128 山形県米沢市八幡原 3 丁目 4 4 6 番 3 号 米沢ダイヤエレクトロニクス株式会社内 Yamagata (JP).
- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR PRINTED CIRCUIT BOARD MATERIAL, AND PREPREG, RESIN SHEET, METAL FOIL-LAMINATED BOARD, AND PRINTED CIRCUIT BOARD EMPLOYING SAME

(54) 発明の名称: プリント配線板材料用樹脂組成物、並びにそれを用いたプリプレグ、樹脂シート、金属箔張積層板、及びプリント配線板

(57) Abstract: Provided is a resin composition for use as a material of the insulating layer of a printed circuit board that includes an insulating layer and a conductor layer formed by plating of the surface of the insulating layer, the resin composition including (A) an epoxy compound, (B) a cyanic acid ester compound, (C) a maleimide compound, (D) an inorganic filler, and (E) imidazole silane, wherein the maleimide compound (C) includes a prescribed maleimide compound, the maleimide compound (C) content, expressed with respect to 100 mass% of the total content of the epoxy compound (A), the cyanic acid ester compound (B), and the maleimide compound (C), is 25 mass% or less, and the imidazole silane (E) includes a compound represented by the following formula (3).

(57) 要約: 絶縁層と、該絶縁層の表面にめっきにより形成される導体層と、を含むプリント配線板の前記絶縁層の材料として用いられる、樹脂組成物であって、エポキシ化合物 (A)、シアン酸エステル化合物 (B)、マレイミド化合物 (C)、無機充填材 (D)、及びイミダゾールシラン (E) を含み、前記マレイミド化合物 (C) が、所定のマレイミド化合物を含み、前記マレイミド化合物 (C) の含有量が、前記エポキシ化合物 (A)、前記シアン酸エステル化合物 (B)、及び前記マレイミド化合物 (C) の合計含有量 100 質量% に対して、25 質量% 以下であり、且つ、前記イミダゾールシラン (E) が、下記式 (3) で表される化合物を含む、樹脂組成物。

WO 2014/196501 A1